

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2025-005

锦州神工半导体股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
- 不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公司股东的净利润为41,150,745.84元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配

方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。公司总股本170,305,736股，扣除回购专用账户950,416股，可参与利润分配股数169,355,320股，合计拟派发现金红利12,701,649.00元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.87%，2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,036,737.29元，现金分红和回购金额合计22,738,386.29元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例55.26%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	12,701,649.00	-	16,000,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,150,745.84	-69,109,826.01	158,141,626.89
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	391,537,637.04		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	28,701,649.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	43,394,182.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	28,701,649.00		
现金分红比例（%）	66.14		

现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	86,849,444.75
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	976,999,170.72
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.89
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，

不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日